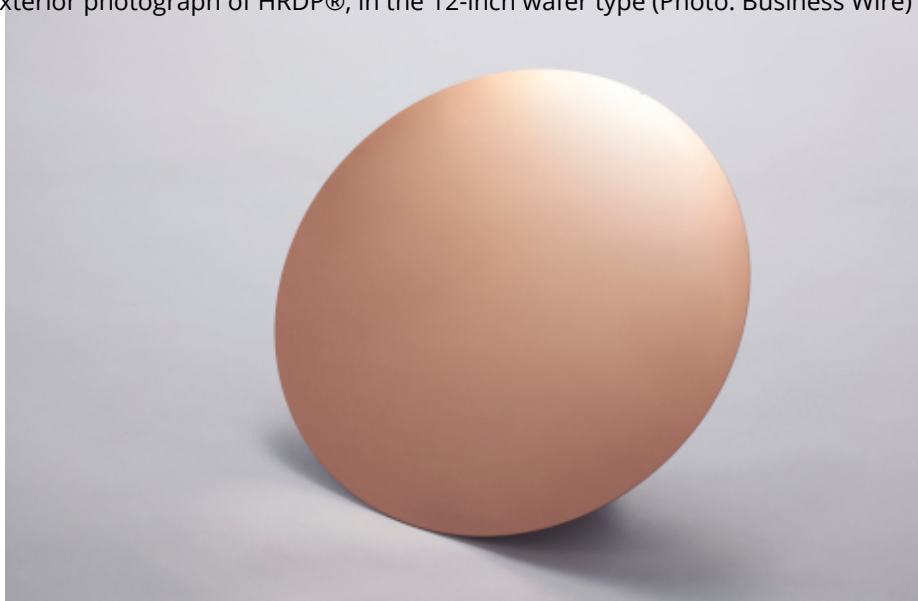


# Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. s'apprête à lancer la production de masse du HRDP®, support en verre spécial destiné au conditionnement des semiconducteurs de nouvelle génération

Dans le cadre de la commercialisation du HRDP<sup>®1</sup>, support en verre spécial destiné aux dispositifs d'emballage des semiconducteurs de nouvelle génération, Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. (président : Keiji Nishida ; ci-après désignée « Mitsui Kinzoku ») étend l'établissement d'un système destiné à la production de masse en collaboration avec GEOMATEC Co., Ltd. (président : Kentaro Matsuzaki). Mitsui Kinzoku est ravie d'annoncer aujourd'hui le lancement de la production de masse du HRDP<sup>®</sup> en faveur d'un fabricant national de modules multipuces.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : <https://www.businesswire.com/news/home/20210124005030/fr/>

Exterior photograph of HRDP®, in the 12-inch wafer type (Photo: Business Wire)



Dans son communiqué de presse de janvier 2018, Mitsui Kinzoku avait annoncé le développement du HRDP<sup>®</sup>, matériau destiné à la création de circuits ultrafins recourant à un support en verre pour la technologie « Fan Out panel level package », sur la base de la méthode RDL First<sup>2</sup>.

Le HRDP<sup>®</sup> est un support en verre spécial capable d'atteindre une efficacité de production élevée pour les emballages Fan Out<sup>3</sup>, technologies de conditionnement des semiconducteurs de

nouvelle génération, notamment les circuits à ultra-haute densité conçus avec un rapport ligne/espace (L/S) inférieur ou égal à 2/2  $\mu\text{m}^4$ . Actuellement, plus de 20 clients procèdent à l'évaluation du HRDP® en vue d'une commercialisation.

En tant que première étape, la production de masse pour un fabricant national de modules multipuces a débuté en janvier 2021. Ce client utilisera le HRDP® pour fabriquer des appareils destinés au marché de la 5G, qui devrait se développer à l'avenir, notamment des modules RF<sup>5</sup>, ainsi que d'autres dispositifs destinés à un éventail d'applications avec pour objectif d'accroître les ventes.

En tant que deuxième étape, un fabricant d'emballages étranger de premier plan prévoit d'adopter le HRDP® au cours de l'exercice financier 2021.

En outre, il est prévu de lancer la production de masse pour les autres nouveaux clients dans le cadre d'un éventail d'applications, telles que l'informatique haute performance (HPC)<sup>6</sup> et les téléphones mobiles au cours de l'exercice financier 2022 et au-delà, et le marché du HRDP® devrait croître.

Sous son slogan Material Intelligence (intelligence des matériaux), Mitsui Kinzoku concrétisera le désir de ses clients recherchant une qualité stable et un approvisionnement suffisant, et fournira à ses clients des solutions complètes, tout en s'efforçant d'accroître sa part de marché.

## Description des termes

<sup>1</sup> Abréviation de High Resolution De-bondable Panel

<sup>2</sup> Méthode Re-Distribution Layer First : les puces de semiconducteurs sont conditionnées à l'issue du processus de formation de la couche de redistribution

<sup>3</sup> Emballage Fan Out : technologie de conditionnement sans substrat dotée d'une couche de redistribution ultrafine étendue au-delà de la taille de la puce

<sup>4</sup> L/S = 2/2  $\mu\text{m}$  : largeur de la ligne égale à 2  $\mu\text{m}$ , et espace entre les lignes de circuits voisins égal à 2  $\mu\text{m}$ .

<sup>5</sup> Module radiofréquence : produit équipé de plusieurs composants actifs (circuits intégrés) et de composants passifs (SAW, condensateur, résistance et bobine) soudés

<sup>6</sup> Informatique haute performance : ordinateur doté de capacités de calcul/traitement à ultra-haute vitesse et à grande échelle

Référence

« Development of HRDP<sup>®</sup> Material for Formation of Ultra-Fine Circuits with Glass Carrier for Fan Out Panel Level Package » (Communiqué de presse du 25 janvier 2018)

[https://www.mitsui-kinzoku.com/Portals/0/resource/uploads/topics\\_180125e.pdf?TabModule127](https://www.mitsui-kinzoku.com/Portals/0/resource/uploads/topics_180125e.pdf?TabModule127)

Vidéo de la méthode RDL First en utilisant le HRDP<sup>®</sup>

<https://www.youtube.com/watch?v=vHhng-NV9QA>

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.



Consultez la version source sur [businesswire.com](https://www.businesswire.com) :  
<https://www.businesswire.com/news/home/20210124005030/fr/>